

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于投资集成电路用电子级功能粉体材料建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）集成电路用电子级功能粉体材料建设项目。
- 投资金额：约人民币 12,800 万元（最终投资总额以实际投资为准）。
- 项目选址：建设地点位于江苏省连云港市高新区。
- 相关风险提示：集成电路用电子级功能粉体材料建设项目内部管理风险在可控范围内，但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

一、项目投资概述

（一）项目投资的基本情况

电子材料是电子信息技术的基础和先导，是电子信息领域孕育新技术、新产品、新装备的“摇篮”。随着 5G 通讯、AI、HPC 等新兴技术发展，5G 通讯用高频高速基板、IC 载板、高端芯片封装等市场迎来了良好的发展机遇。同时对集成电路用到的电子级功能粉体材料提出了小粒径、低杂质、大颗粒控制、高填充等不同特性要求。为了优化升级及淘汰现有部分产能，提升自动化智能化制造水平及生产效能以及更好满足客户多品种小批量订单的需求，公司拟投资人民币 12,800 万元建设集

成电路用电子级功能粉体材料项目，以满足集成电路用电子级功能粉体材料市场需求。

（二）项目投资的决策与审批程序

2023年10月25日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资集成电路用电子级功能粉体材料建设项目的议案》。会议应到会董事7人，实到董事7人；议案表决结果为7人同意、0人反对、0人弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本次项目投资事项无需提交股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- 1、项目名称：集成电路用电子级功能粉体材料建设项目；
- 2、项目实施单位：江苏联瑞新材料股份有限公司；
- 3、项目投资总额及资金来源：项目投资总额约人民币12,800万元，最终项目投资总额以实际投资为准，资金来源将通过公司自筹资金等方式完成；
- 4、项目选址：建设地点位于江苏省连云港市高新区；
- 5、设计产能：项目设计产能为25200吨/年；
- 6、项目建设周期：24个月。

三、项目投资对公司的影响

公司本次投资事项系公司主营业务，符合公司战略发展规划，项目建设完成将持续满足5G通讯用高频高速基板、IC载板、高端芯片封装等应用领域对集成电路用电子级功能粉体材料越来越高的特性要求，进一步提升公司自动化智能化制造水平及生产效能，对促进公司与客户建立持续稳定的战略合作伙伴关系及长期稳定发展具有重要意义。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，从长远来看对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

四、项目投资的风险分析

投资集成电路用电子级功能粉体材料建设项目内部管理风险在可控范围内，但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2023年10月26日